

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第七次会议于2024年4月9日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2024年4月19日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事沈琦先生、沈馥先生及沈锡强先生回避表决。

2023年9月12日,公司召开第六届第三次董事会,审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》,公司与沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先进”)共同投资沈阳亦创精密科技有限公司(以下简称“沈阳亦创”),并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司(以下简称“雅克科技投资方”,雅克科技为控股股东)与沈阳先进成立的有限合伙企业(以下简称“沈阳先进投资方”)共同增资沈阳亦创(“本次投资”),由沈阳亦创与SK enpulse Co., Ltd.(以下简称“SK enpulse 公司”)签署《收购协议》,购买其持有的SKC solmics Hong Kong Limited(以下简称“SSHK”)90%的股权(以下简称“本次股权收购事项”)。通过本次股权收购事项,沈阳亦创将通过SSHK间接持有其下属全资子公司爱思开希半导体材料(无锡)有限公司90%的股权。截止目前,本次股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。

为了本次股权收购事项顺利进行,沈阳亦创拟向金融机构申请项目贷款人民

币 12,960 万元。后续，在雅克科技投资方和沈阳先进投资方的投资款到位后，该笔项目贷款将置换成流动贷款，用于交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司的日常生产经营。

公司目前持有沈阳亦创 33.33%的股权，拟就沈阳亦创前述项目贷款提供不超过人民币 3,119.4720 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保协议的主要内容以公司与银行签订的合同为准。

公司本次拟为参股公司向金融机构申请的项目贷款提供相应担保，主要是为了保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进，满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司日常生产经营的资金需求。公司本次拟提供的担保未超过持股比例，沈阳亦创的股东沈阳先进、法定代表人郑广文控股的北京亦盛精密半导体有限公司分别就沈阳亦创的前述贷款提供全额担保，并且沈阳亦创向公司提供了反担保，担保方式公平、对等，本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大不利影响。

因公司控股股东、实际控制人之一沈琦先生担任沈阳亦创的董事，因此沈阳亦创为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日